

SuperView W3

Profilomètre optique de surface 3D

Forme de rugosité 3D microscopiques à grande échelle

- Grande table
- Compatibilité avec wafer 12 pouces
- Mesure automatique en une touche



Parameters

Référence		SuperView W3	
Dimensions		(1000x800x1550)mm	
Poids		500 kg	
Source lumineuse		White LED	
Système vidéo		1024x1024	
Objectif		10x(2.5x, 5x, 20x, 50x, 100x optional)	
Zoom optique		0.5x(0.75x, 1x, 0.375x optional)	
Champ de vision standard		0.98x0.98mm	
Tourelle d'objectifs		Motorized 5 holes turret	
XY Object Table	Dimensions	450x450mm	
	Course de déplacement	300x300mm	
	Capacité de charge	10kg	
	Méthode de contrôle	Motorized	
Inclinaison		±5°Motorized	
Z Axis	Course de déplacement	100mm	
	Méthode de commande	Motorized	
Plage de balayage de l'axe Z		10mm	
Z Résolution		0.1nm	
Répétabilité de la rugositéRMS ^{*1}		0.005m	
Mesure de hauteur de marche	Précision ^{*2}	0.3%	
	Répétabilité ^{*2}	0.08% 1σ	
Exigences environnementales			
1	Environnement de fonctionnement : pas de champ magnétique intense, pas de gaz corrosif	4	Vibration environnementale : VC-C ou mieux
2	Température de fonctionnement : 0 °C à 30 °C, fluctuation < 2 °C/60 min	5	Air comprimé : 0,6 MPa, sans huile ni eau
3	Humidité relative : 5 % à 95 % HR, sans condensation	6	Puissance: 300W

Note:
*1 Mesure d'un wafer silicium Sa 0,2 nm en environnement de laboratoire conformément à la norme ISO 25178
*2 Mesure d'un bloc étalon de hauteur de marche 5 µm en environnement de laboratoire conformément à la norme ISO 10610-1:2009

Fonctions dédiées au domaine des semi-conducteurs

- Mesure du profil des tranchées après rainurage laser lors du processus de découpe (dicing)
- Mesure de la hauteur de marche de film sur wafer dans une plage de 1 nm à 1 mmMesure de la rugosité de feuilles de silicium après processus de meulage, avec mesure de plusieurs zones et calcul de la valeur moyenne en un clic
- Support des wafers 6", 8" et 12", avec changement automatique des 3 tailles de mandrins à vide en un clic